

10月30日(木)10:00-12:30	コース	10月30日(木)14:00-16:40	10月31日(金)12:35-14:50	10月31日(金)15:15-17:30
<p>KM-1 挨拶・基調講演 10:00-12:30 (受付・ウエルカムコーヒー 9:30 開始)</p> <p>司会:中村 孝(大阪大学)</p> <p>◆来賓挨拶 京都府知事 (予定) 京都市長 (予定)</p> <p>◆基調講演 「日本の半導体戦略について」 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 課長 南部 友成</p> <p>◆基調講演 「AIと自動車アプリをコアに2030年の電子デバイス産業は200兆円に!!」 ㈱産業タイムズ社 取締役会長 泉谷 渉</p> <p>◆基調講演 「科学技術で社会に貢献する」島津製作所の150年の歴史と経営戦略」 ㈱島津製作所 経営戦略室 室長 岩切 省吾郎</p>	<p>【A】</p> <p>【A】</p> <p>新世代モビリティ</p> <p>【B】</p> <p>話題の新技术</p>	<p>A-1 特別企画</p> <p>戸所義博(イーセップ)/山崎治(シャープフロンティアAT)</p> <p>◆新たな変革を迫られる自動車業界:電動化、SDV化、開発等を踏まえた事業転換の必要性 PwCコンサルティング合同会社 ①スマートモビリティ総合研究所 リサーチ&インサイトリーダー 森崎 崇 ②DX-SBX シニアアシエイト 飯嶋 清貴 ③DX-SBX アソシエイト 豊島 優 ◆カーボンニュートラル実現に向けたEV技術とパワーエレクトロニクス、パワーデバイスの進化 ㈱トヨタテクノロジーズ 執行役員・トヨタ自動車副主査 福田 幸司</p> <p>B-1 ロボティクス</p> <p>酒井滋樹(日新イオン機器)/平澤拓(パナソニック)</p> <p>◆ヒューマノイドロボットとサービスロボットの技術者から見たビジネス展望 ㈱シンクロボ 代表取締役社長 小倉 崇 ◆エッジAIが実現する「器用な」ロボット。Thinkerがもたらす現場のシカ ㈱Thinker CTO 中野 基輝 ◆WORKROID WE CREATE ~新しい発想でつくる、ロボットとともにある未来のカタチ~ ㈱テムザック 代表取締役社長 川久保 勇次</p> <p>C-1 EUV、ついに・日本上陸、今その技術の全貌が...</p> <p>山本浩之(マイクロン)/廣田良浩(ワイドヴィル)</p> <p>◆最先端EUVリソグラフィ技術と統合型リソグラフィ技術で切り拓く半導体の未来 ASML Japan(㈱) Head of Technical Marketing Corporate Marketing 永原 誠司 ◆EUVレジストの軌跡と更なる飛躍 JSR(㈱) 電子材料事業部 精密電子開発センター長 丸山 研 ◆High NA EUV量産に向けた先進的な塗布現像装置の技術 東京エレクトロ九州㈱ プロセス技術部 CT基礎開発グループ グループリーダー 塩澤 崇博</p>	<p>A-2 SDV/自動運転</p> <p>松浦正純(FLOSFIA)/山崎治(シャープフロンティアAT)</p> <p>◆SDV開発に向けた仮想環境プラットフォーム ㈱デンソー フットウェア開発部 上級キャリアエキスパート 岩井 明史 ◆SDV時代の車載半導体SoCの現状と進化 インフォマティクスシステムズ株式会社 プリンシパルコンサルタント 鈴木 寿哉 ◆ドライブレコーダーとその安全活用 群馬大学 次世代モビリティ社会実装研究センター(CRANTS) 協力研究員 久保 豊</p> <p>B-2 サーマルエンジニアリング</p> <p>平澤拓(パナソニック)/泉谷淳子(村田製作所)</p> <p>◆データセンターの放熱・冷却技術の最新動向 ㈱ サーマルデザインラボ 代表取締役 国峯 直樹 ◆半導体パッケージの熱シミュレーションモデル-SPTP-パナソニックインダストリー(㈱) 技術本部 エネルギータリコレーション開発センター シニアエキスパート 熊野 豊 ◆薄型ベーパーチャンバーの性能向上に向けた設計について ㈱村田製作所 事業インキュベーションセンター 新商品事業化推進部 シニアマネージャー 玉山 孟明</p> <p>C-2 進化し続けるデバイス構造・プロセス技術・装置技術</p> <p>森義弘(SCREEN)/廣田良浩(ワイドヴィル)</p> <p>◆最先端ロジック半導体デバイス技術の進化:FinFET からGAAそしてOFETへ 東京大学 生産技術研究所 教授 平本 俊郎 ◆3次元フラッシュメモリにおけるメタリゼーションとCMOS Directly Bonded to Array(CBA)技術 キオクシア(㈱) 先端メモリ開発センター 先端メモリ研究開発部 グループ長 田上 政由 ◆AI時代の半導体パッケージ技術: 巨大化と微細化を支えるマスクレス露光装置の重要性 ㈱SCREENセミコンダクターソリューションズ フロンティア技術統轄部 露光プロダクト部 長尾 竜也</p>	<p>A-3 パワーデバイス</p> <p>松浦正純(FLOSFIA)/中村孝(大阪大学)</p> <p>◆EV用SiCパワーモジュールの可能性と市場展望 ㈱矢野経済研究所 インダストリアルテクノロジーユニットフェロー 理事研究員 池田 智也 ◆データセンター向けサーバー用高機能CPU/GPU/パワーデバイス冷却相変態型冷却器サイロックスの紹介 住友精密工業(㈱) データセンター-サーマルソリューションプロジェクトチーム 兼 熱エネルギー技術部 汎用グループ マネージャー 花房 翔大 ◆SiC/パワーデバイスの現状と将来展望 国立研究開発法人産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター 研究センター長 田中 保直</p> <p>B-3 光通信技術・応用</p> <p>妹尾和則(NTT研究所)/泉谷淳子(村田製作所)</p> <p>◆LNの光変調器応用と薄膜LN技術による高速化及び高集積化 古河ファイナルオプティカルコンポーネンツ(㈱) オプティカルコンポーネンツ事業部 マネージャー 牧野 俊太郎 ◆光ディスクアグリゲータッドコンピューティングの現在地 NTT(㈱) デバイスインノベーションセンター 主任研究員 村中 勇介 ◆冷却原子型量子コンピュータの研究開発 ㈱Yaqumo 取締役 CTO 中村 勇真</p> <p>C-3 AI 時代を支え進化し続ける半導体デバイス技術、設計技術</p> <p>山本浩之(マイクロン)/三富士道彦(ローム)</p> <p>◆AI時代における半導体設計革新とデジタルツ윈の可能性 シームレスEDAジャパン(㈱) 技術本部 本部長 丁子 和之 ◆LPDRAM Evolution: LP6 and beyond マイクロンメモリジャパン(㈱) DRAM Engineering Group LPDDR Design Engineering SR Director 石川 透 ◆CBA(CMOS Directly Bonded to Array)技術による3次元フラッシュメモリの高性能化 キオクシア(㈱) メモリ開発戦略部 メモリ開発戦略第二担当 参事 小林 茂樹</p>
<p>10月31日(金)9:20-11:45</p> <p>KM-2 マーケティングセッション 9:20-11:45 (受付 8:50 開始)</p>	<p>【C】</p> <p>The 半導体</p>	<p>D-1 技術・マーケットトレンド [13:50-16:45]</p> <p>森川泰宏(ULVAC)/藤原健典(東レ)</p> <p>◆半導体実装技術・マーケットトレンド ~チップレット・PLP・OPD...AI時代における技術~ ㈱SBRテクノロジー 代表取締役 西尾 俊彦 ◆先端チップレットインテグレーション技術と材料 Rapidus(㈱) エンジニアリングセンターフェロー 野中 敏夫 ◆Customization & Energy-efficiency Improvement with Advanced Packaging for AI Era 日本サムソン(㈱) 常務 Samsungデバイスソリューションズ研究所 Advanced Packages Lab 古谷 俊樹 ◆ポリマー光導波路の設計・作製とCo-Packaged Opticsへの応用 慶応義塾大学理工学部 物理情報工学科 教授 石塚 崇明</p>	<p>D-2 光電融合</p> <p>不破保博(元ローム)/藤原健典(東レ)</p> <p>◆メンブレン化合物半導体光デバイスを用いた光電融合デバイスの研究開発 NTT(㈱) 先端集積デバイス研究所 フェロー 松尾 慎治 ◆異種材料接合を用いたInP/Siフォトニクス光集積回路技術 住友電気工業(㈱) 伝送デバイス研究部 主幹・シニアスペシャリスト 八木 英樹 ◆AIデータセンター時代を支える多心光コネクタ技術の最新動向 ㈱白山 取締役 マーケティング・事業開発最高責任者 金原 竜生</p>	<p>D-3 先端PKG</p> <p>不破保博(元ローム)/森川泰宏(ULVAC)</p> <p>◆ガラスコアの技術動向 大日本印刷(㈱) ファインパッケージング本部 技術第2部 副部長 藤本 興治 ◆先端半導体パッケージサイズ拡大におけるモールドング技術の動向 TOWA(㈱) 市場開発部 営業技術課 シニアリーダー 寺本 翔太 ◆先端半導体パッケージ向けガラス基板用TGV用シード層および確證網のめっきの開発動向 奥野製業工業(㈱) 総合技術研究部 基板半導体領域 領域長 吉川 純二</p>
<p>司会:廣田良浩(ワイドヴィル)</p> <p>◆特別講演 「混迷深まる世界情勢における半導体・装置・電子部品市場見通し」 ㈱産業タイムズ社 大阪支局 支局長 電子デバイス産業新聞 副編集長 中村 剛</p> <p>◆特別講演 「2026年度以降のグローバル市場動向と注目すべき半導体市場の今後の見通し」 Semi Business Consulting(㈱) Chief Consultant & Co-Founder 南川 明</p> <p>◆特別講演 「テクノロジーハードウェア業界見通し:スマホなど完成品・AIサーバー一帯見通し、FPDやCMOSセンサーなど部品視点も」 みずほ証券(㈱) エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ、シニア・アナリスト 中根 康夫</p>	<p>【D】</p> <p>跳躍の最先端パッケージ・実装技術</p> <p>【E】</p> <p>特別セッション</p>	<p>E-1 大学セッション(無料) [13:50-16:45] データ活用による、研究~製造の今後の展開</p> <p>今本浩史(京都大学)/向井雅昭(京都工芸繊維大学)</p> <p>◆IoTビッグデータのためのAI技術 大阪大学 産業科学AIセンター センター長 教授 橋井 保志 ◆有機エレクトロニクス研究のラボオートメーション 山形大学 有機エレクトロニクス研究センター 教授 兼 センター長 松井 弘之 ◆電子ラボオートメーションと研究DXの推進とデータ駆動型サイエンスの社会実装 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成科学領域 マテリアルズ・インフォマティクス研究室 助教 高須 聖五 ◆オープンアクセスとデータ駆動型研究を推進するための京都大学の取り組み 京都大学 情報環境機構 データ運用支援基盤センター センター長・教授 瀧美 紀寿</p>	<p>E-2 AI・ニューロモーフイック半導体</p> <p>浦岡行治(NAIST)/中村孝(大阪大学)</p> <p>◆AIチップとデバイス技術の進化:インメモリコンピューティングの可能性 日本アイ・ピー・エム(㈱) 東京基礎研究所 シニア・リサーチ・サイエンティスト 岡崎 篤也 ◆AIをハードウェアで実現するニューロモーフシステム 龍谷大学 先端理工学部 教授 木村 睦 ◆有機フロンティアゲートメモリの開発と人工シナプスデバイスへの応用 大阪公立大学 大学院工学研究科 電子物理系専攻 准教授 永瀬 隆</p>	<p>E-3 やはり目が離せない! アジア半導体産業の動き中・韓・印 アジア半導体産業の最新線を追う!</p> <p>戸所義博(イーセップ)</p> <p>◆中国・インド半導体産業の現在地 ~さらに高まる存在感と投資熱~ ㈱産業タイムズ社 代表取締役社長 電子デバイス産業新聞 特別編集委員 津村 明宏 ◆米中半導体競争をめぐる日韓コラボの行方 ~増激化するHBM(広帯域メモリー)市場の争奪戦~ ㈱産業タイムズ社 ソウル支局長 巖 在漢</p>